

極細専用やに入りはんだで、超微細接続

An ultrathin resin flux cored solder designed for superfine soldering

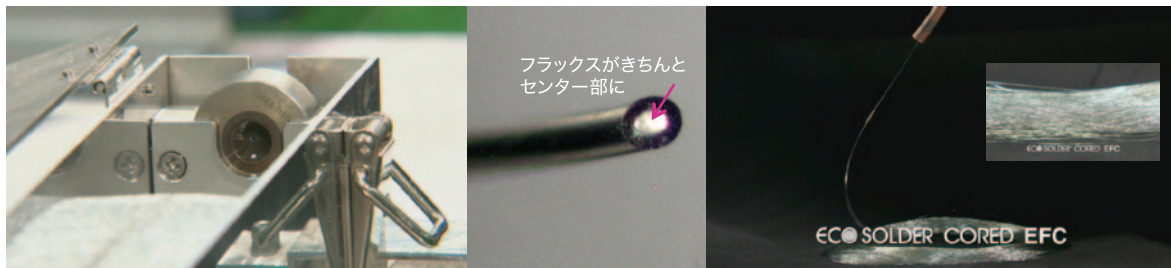
特長

- 伸線工程が安定し、強度など極細線固有の品質を向上
- 専用フラックスの開発で、低飛散化の実現とブリッジの発生を抑制
- はんだ切れ性を向上させ、極微細接続を実現



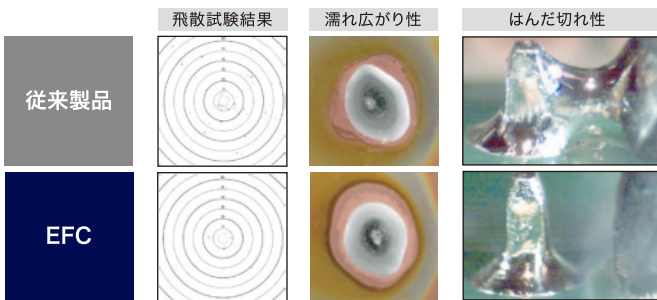
仕様

- 独自の伸線技術で、伸線時の断線やくびれを低減し、品質の高い極細線を提供



φ0.1mmやに入りはんだ

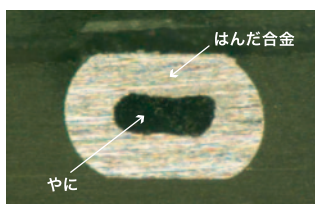
- 低飛散、良好な濡れ性、良好なはんだ切れ性で超微細接続を実現



- 各種合金のハロゲンフリーEFCで極微細接続を実現



- 極細やに入りはんだFLAT COREを、リフロー炉で狭ピッチ実装



M705 φ0.25mmを加工

